

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<div><div>☐特定对象调研</div><div>☐分析师会议</div><div>☐媒体采访</div><div>☒业绩说明会</div><div>☐新闻发布会</div><div>☐路演活动</div><div>☐现场参观</div><div>☐其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	线上参加蓝箭电子2025年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月08日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 张顺 董事、总经理 袁凤江 董事、副总经理、财务总监 赵秀珍 董事、副总经理、董事会秘书 张国光
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>1. 请问公司2025年度整体营业收入和归母净利润的同比变动情况如何？主要影响因素有哪些？</div><div>答:尊敬的投资者，您好！2025年公司实现营业收入71,197.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润-3,737.11万元。主要受消费电子需求偏弱、行业竞争加剧、原材料价格上涨、人工成本增加等因素影响。关于2025年年度整体经营情况详细请参见公司已披露的2025年年度报告。感谢您的关注。</div><div>2. 请公司简要介绍参股公司深圳芯展速目前的股权构成情况，以及主要投资方背景，是否有行业内知名产业资本参与？</div><div>答:尊敬的投资者，您好。芯展速作为专注于企业级存储与主控芯片领域的企业，本轮融资引入了多具备行业影响力的产业资本及专业投资机构，其中包括浙江大华投资管理有限公司、合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴华宴创睿创业投资合伙企业（有限合伙）等资本及产业方相关的机构共同参与。多方产业资本的加入，有助于芯展速整合资源、提升技术与市场竞争力，也为公司未来产业链协同发展创造了良好条件，感谢您的关注。</div><div>3. 请问公司目前收购成都芯翼的进展情况如何？</div><div>答:尊敬的投资者，您好！公司已于2026年1月与成都芯翼科技有限公司签署股权收购框架性协议。目前正在进行尽职调查、审计和评估工作，公司将依据交易事项后续进展情况，严格遵循</div></div>

	<p>上市公司规范运作和信息披露要求进行信息披露。感谢您的关注！</p> <p>4. 请问公司年度利润分配方案的情况是什么？未来在股东回报策略上有何规划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。在综合考虑公司实际经营情况、资金需求与长期发展等方面考虑，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。感谢您的关注！</p> <p>5. 请介绍公司参股深圳芯展速的战略定位与布局考量，以及芯展速在公司整体产业链中的作用与定位。</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司对芯展速的投资，是结合芯展速在半导体高性能企业级存储主控芯片、企业级SSD产品、数据服务领域等优势和公司封装测试领域的技术与制造能力，有助于公司拓展新的应用场景、丰富产业生态。本次投资是基于半导体产业链协同发展作出的审慎布局，符合公司长期发展方向，有利于提升综合竞争力与抗风险能力。感谢您的关注！</p> <p>6. 请问贵公司最新的股东人数是多少？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，截止2026年3月31日，公司最新的股东总人数为43,033人。关于股东人数及其他股东相关情况，公司会按规定在定期报告中予以披露，敬请关注公司定期报告，感谢您的关注！</p> <p>7. 公司在资产运营和资本结构优化方面有哪些考虑和计划，是否有进一步的融资需求和投资计划？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司将持续优化资产运营效率与资本结构，合理规划资金使用，提高资金收益。公司将根据业务发展需要统筹安排融资事宜，如有融资或对外投资计划，将严格按照规定履行审议与披露程序，敬请关注公司公告。感谢您的关注！</p> <p>8. 请问公司未来的产品布局是怎样的？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司主要从事半导体封装测试业务，提供分立器件和集成电路产品。产品方面，公司持续强化功率器件、宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP及BGA封装工艺、车规级产品、存储芯片封装等领域的研发创新能力；加大晶圆级芯片封装、系统级封装（SIP）投入，在现有SIP技术基础上，进一步拓宽封测服务技术边界与产品种类，实现模拟电路、数字电路、传感器、存储芯片等多领域封测能力全覆盖，巩固并提升核心技术壁垒。封装形式覆盖 DFN/QFN、SOT、SOP、TOLL、TOLT、SIP、Flip Chip 等系列，满足小型化、大功率、高可靠需求。下游应用方面，公司将紧跟半导体封装测试小型化、集成化、高端化、智能化发展方向，聚焦物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、储能、智能电网、工业控制、5G通信射频等具有广阔发展前景的领域，持续优化产品结构，提升高附加值产品占比，满足客户一站式采购需求。感谢您的关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026年05月08日